

### **3D-MICROMAC GIBT DIE EINFÜHRUNG EINES NEUEN SYSTEMS FÜR SELEKTIVES LASER-ANNEALING ZUR HERSTELLUNG VON HALBLEITERN, LEISTUNGSGERÄTEN UND MEMS BEKANNT**

*microPRO RTP nutzt innovative Optik und umfasst Optionen für punktuell Step-and-Repeat, Linienscannen sowie mehrere Wellenlängen, um eine hochflexible Laserplattform bereitzustellen.*

**Chemnitz, Deutschland, 18. September 2017**—3D-Micromac AG, ein führender Anbieter im Bereich Lasermikrobearbeitung und Rolle-zu-Rolle-Lasersysteme für die Branchen Photovoltaik, medizinische Geräte und Elektronik, hat heute die Einführung von microPRO RTP bekannt gegeben. Dabei handelt es sich um ein neues Laser-Annealing-System, das speziell zur Durchführung wichtiger Prozessschritte bei der Herstellung von Halbleitern, Leistungsgeräten und MEMS konzipiert wurde.

Durch die Kombination eines innovativen Laseroptikmoduls mit der hochmodularen 3D-Micromac-Plattform für das Dicing von Halbleiter-Wafern ermöglicht microPRO RTP selektives Annealing mit einem hohen Maß an Wiederholbarkeit und Durchsatz. Das System umfasst eine Option zum Linienscannen für vertikales selektives Annealing, eine Option für punktuell Step-and-Repeat, die zum horizontalen selektiven Annealing eingesetzt wird, sowie drei optionale Wellenlängen-Laser (nahes Infrarot, Grün und Ultraviolett). Damit wird eine äußerst flexible Laser-Annealing-Plattform von hoher Qualität bereitgestellt.

microPRO RTP hat sich für eine Vielzahl von vorhandenen und zukünftigen Anwendungen als geeignet erwiesen, darunter:

- Aktivierung von Dotierstoffen für Bipolartransistoren mit isolierter Gate-Elektrode (Insulated-Gate Bipolar Transistor, kurz IGBT) und rückbeleuchtete CMOS-Bildsensoren
- Erzeugung ohmscher Kontakte in Leistungsgeräten mit Siliziumcarbid (SiC), um die Widerstandsfähigkeit zu verbessern
- Herstellung bestimmter Typen von MEMS-Geräten wie halbleitende Magnetfeldsensoren

microPRO RTP bietet im Vergleich zu herkömmlichen Annealing-Methoden zahlreiche Vorteile. Dazu zählen:

- Hohe Präzision auf der X- und Y-Achse
- Hohe Selektivität in Bezug auf verschiedene Substrate und Beschichtungen, mit mehreren Optionen für Pulslänge, Pulsenergie und Überlagerung, um sicherzustellen, dass keine Schäden in der Umgebung der Zielstelle auftreten
- Sehr hohe Energiehomogenität
- Präzise Überwachung von Laser und Prozess

Die microPRO RTP kann derzeit bei 3D-Micromac bestellt werden.

**-mehr-**

### **NEUES SYSTEMS FÜR SELEKTIVES LASER-ANNEALING.....Seite 2 von 2**

3D-Micromac wird sein Portfolio an Lasersystemen, darunter auch das neue System microPRO RTP auf der 2017 International Conference on Silicon Carbide and Related Materials (ICSCRM) präsentieren, die vom 17. bis 22. September im Wardman Park Marriott in Washington, D.C., stattfindet. Am Stand des Unternehmens (Nummer 207) können Teilnehmer der Konferenz mehr über die Produkte von 3D-Micromac erfahren. Am Dienstag, dem 19. September, stellt 3D-Micromac außerdem sein Produkt TLS-Dicing™ (Thermal Laser Separation bzw. thermisches Laserstrahl-Separieren) für das Dicing bzw. Vereinzeln von SiC-Wafern vor. Die Präsentation findet im Rahmen der Sitzung „Manufacturing Innovations“ auf der ICSCRM statt.

### **Über die 3D-Micromac AG**

Die im Jahr 2002 gegründete 3D-Micromac AG ist der führende Spezialist für Lasermikrobearbeitung. Das Unternehmen steht für leistungsfähige, anwenderfreundliche und zukunftsorientierte Prozesse mit größter Produktionseffizienz.

3D-Micromac entwickelt Verfahren, Maschinen und komplette Anlagen auf höchstem technischen und technologischen Niveau. Die Systeme kommen in vielen Hightech-Branchen weltweit erfolgreich zum Einsatz, zum Beispiel in der Photovoltaik-, Halbleiter-, Glas- und Display-Industrie als auch in der Mikrodiagnostik und der Medizintechnik. Für weitere Informationen besuchen Sie bitte unsere Website unter <http://www.3d-micromac.de>.

### **Kontakt**

3D-Micromac AG

Mandy Gebhardt

Leiterin Marketingkommunikation

Tel: +49 371 40043-26

E-Mail: [gebhardt@3d-micromac.com](mailto:gebhardt@3d-micromac.com)

# # #